

フリップチップボンダ

BP2000LS Flip chip bonder

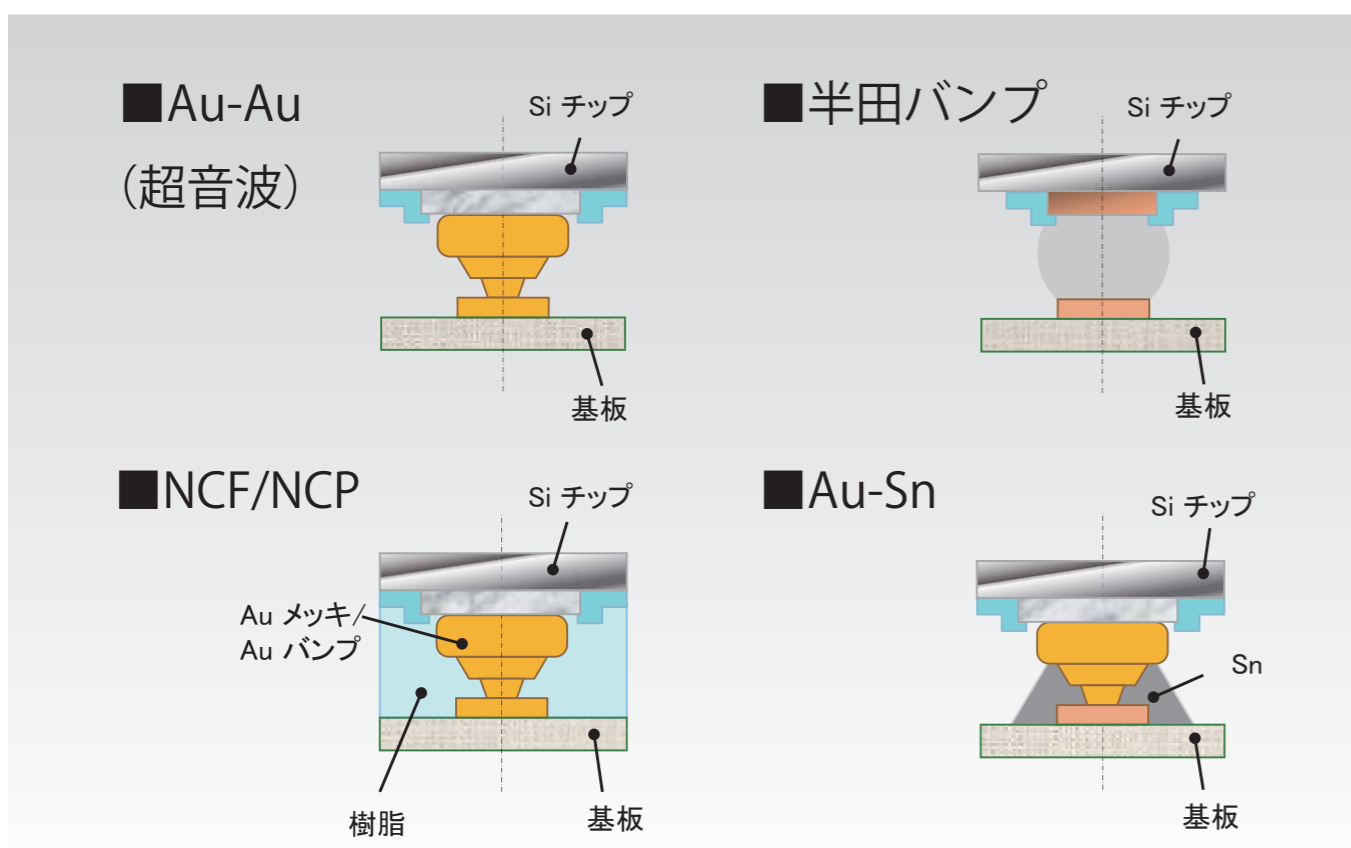
半導体の高精度実装に最適なフリップチップボンダ



ヘッド荷重	荷重 50 ~ 2000N
ヘッド種類	超音波ヘッド (ヒータヘッド、マウントヘッドに交換可)
超音波周波数	周波数: 30 kHz/40 kHz/50 kHz から選択
ヘッド制御	荷重、位置、超音波のデジタル制御
アライメント精度	±5 μm
有効ワークエリア	□200mm
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシピ	接合条件: デジタル設定
ユーティリティ	空圧源 0.5MPa ドライエアー
	電源 本体 200V50A
ユニットサイズ	W1190 x D1090 x H1650mm (本体部)
ユニット重量	800kg

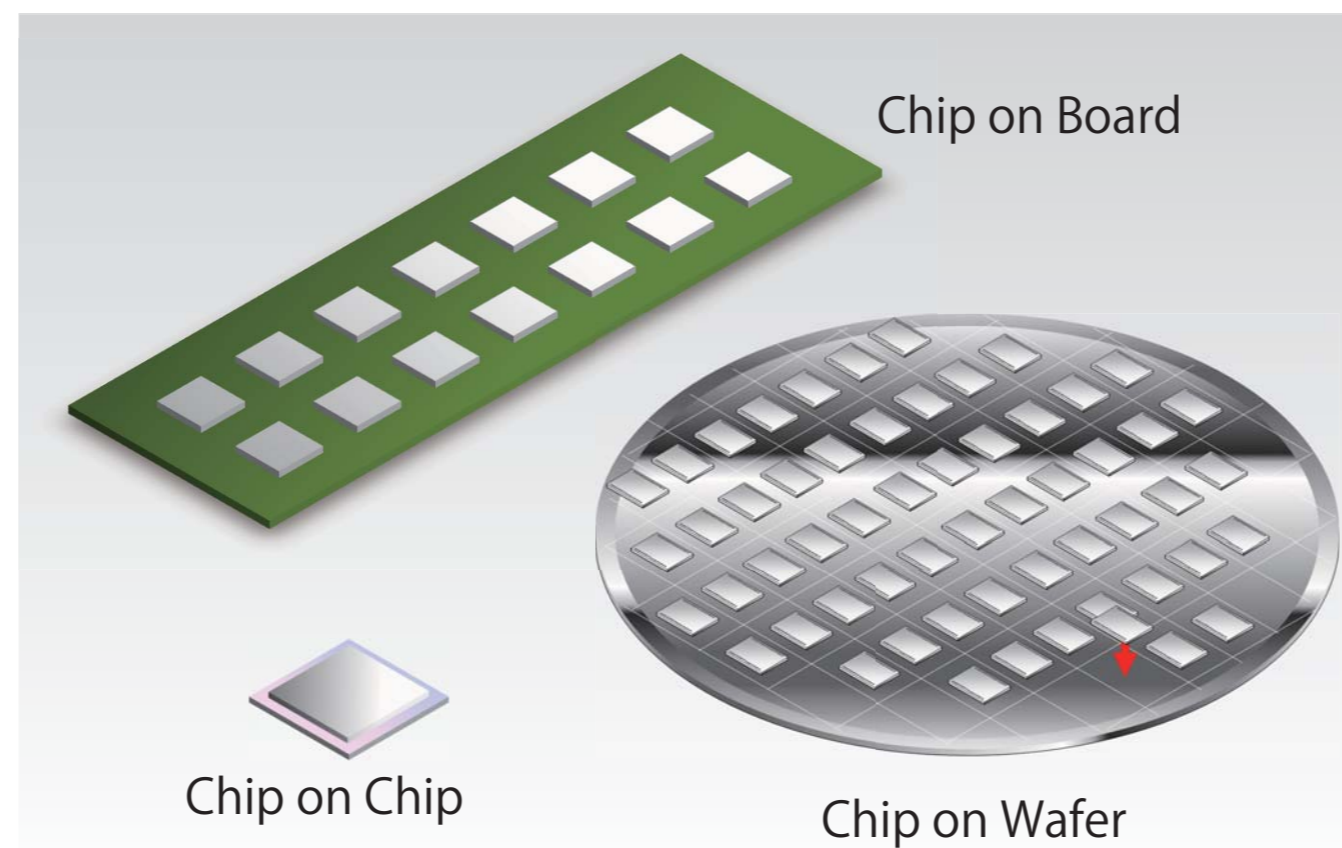
アプリケーション

●接合プロセス事例



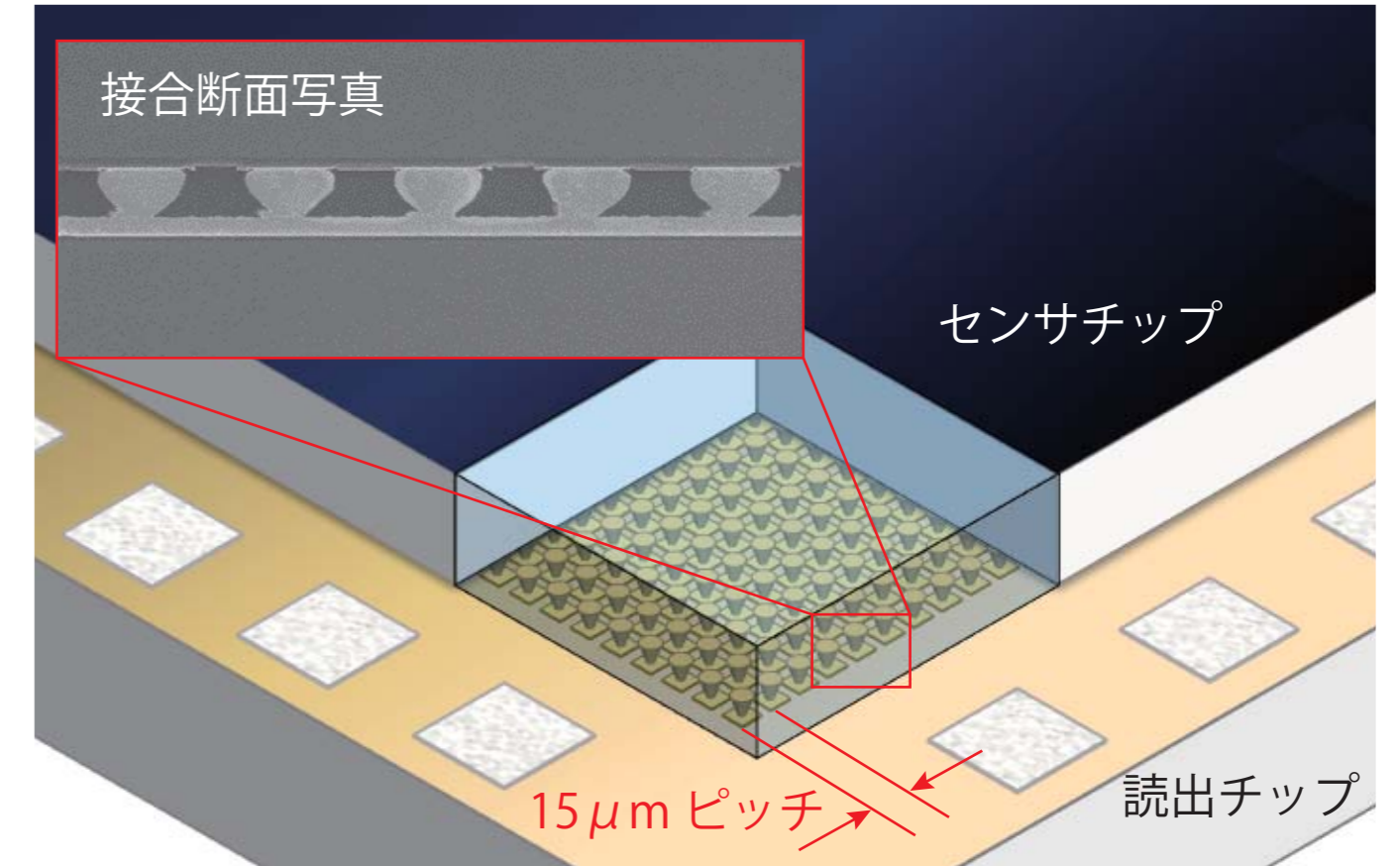
各種接合プロセスに対応

●実装形態事例



ユーザーニーズに合わせてカスタマイズ

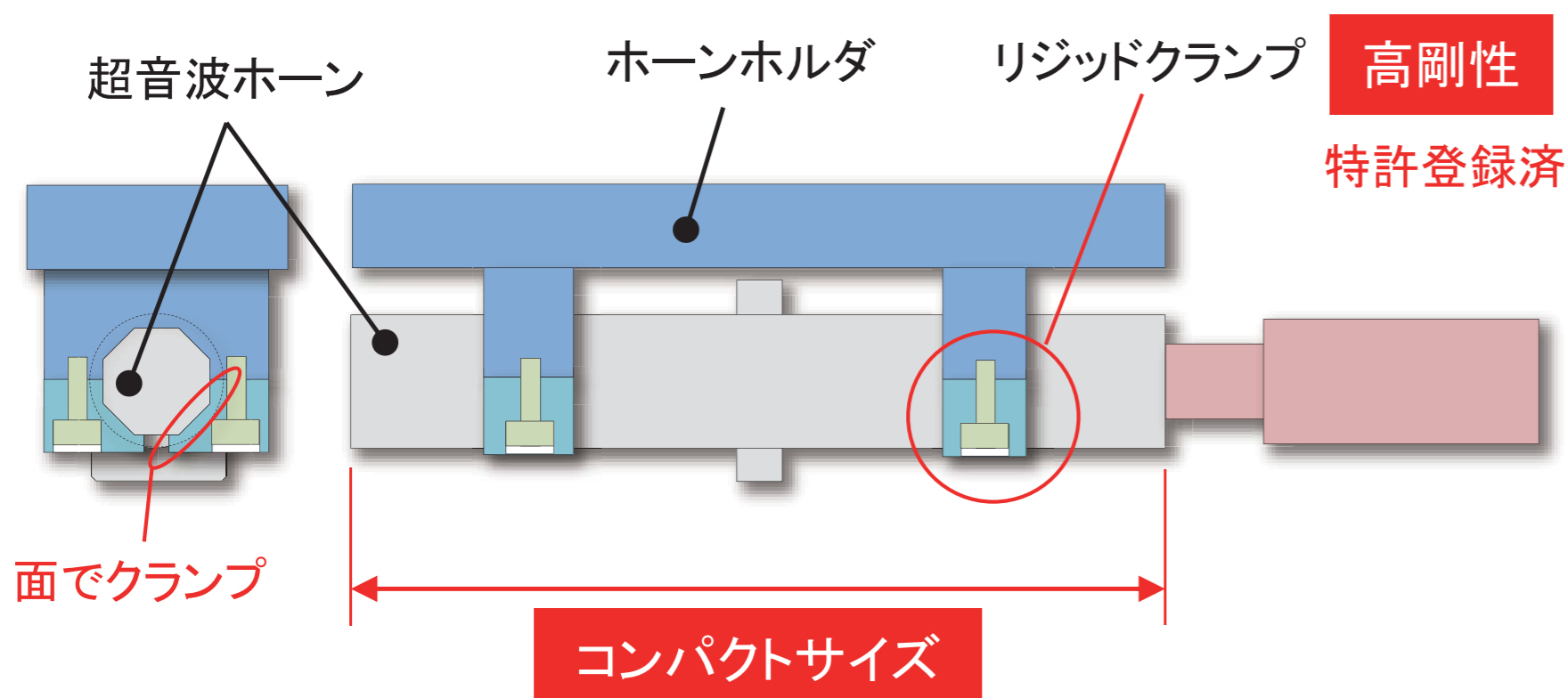
●15 μm ピッチ 30 万バンプ実装事例



15 μm ピッチデバイスを超音波接合

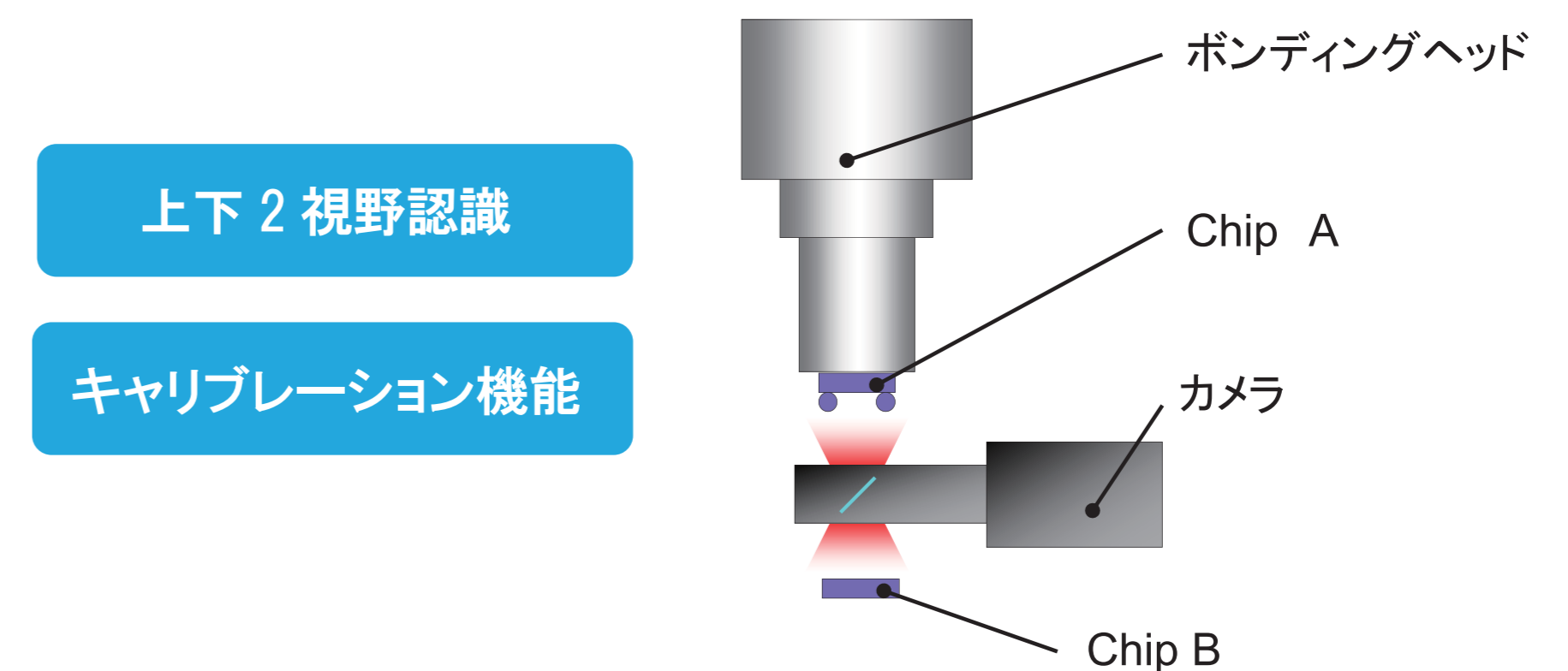
高剛性ホーンクランプ機構

【リジッドクランプ】によって、超音波ホーンをダイレクトにクランプ。高剛性クランプにより高荷重でも高い平面度を確保。



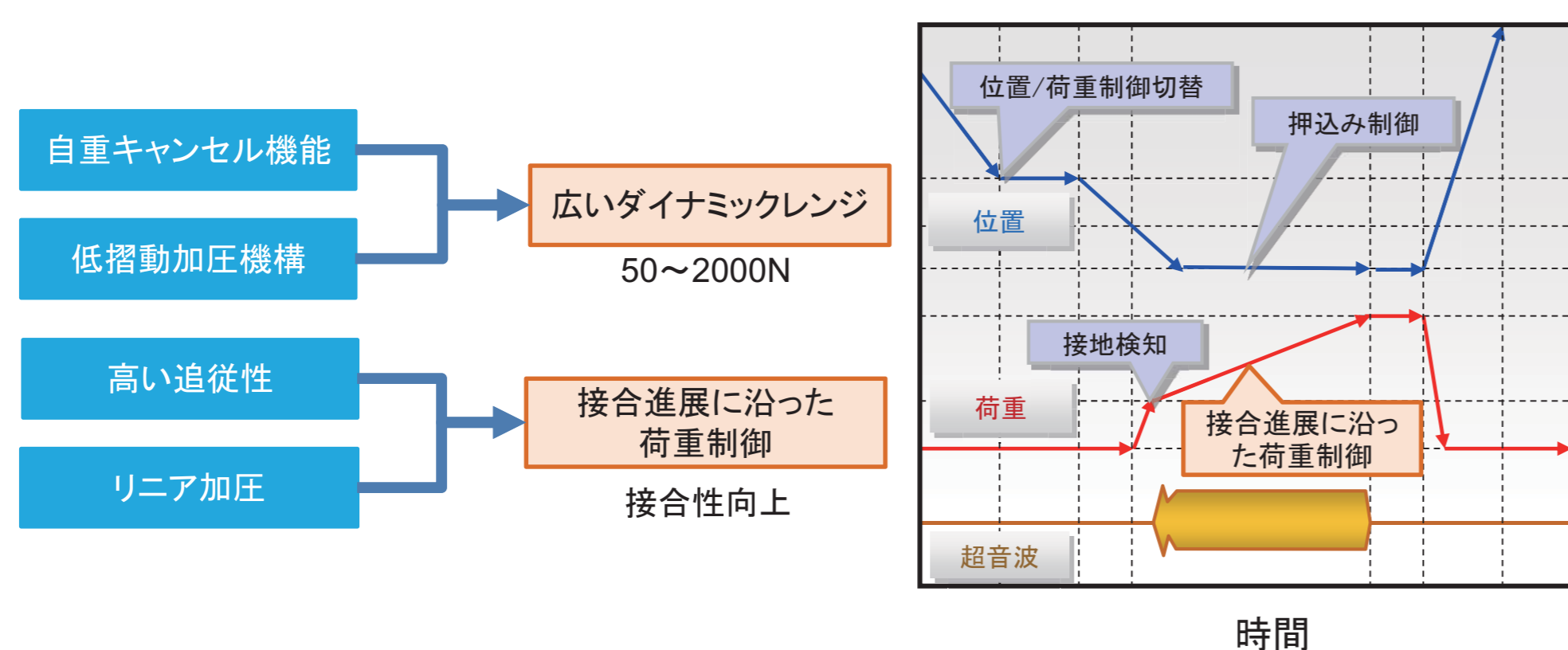
高精度アライメント

上下2視野認識に加え、経時変化を補正する【アライメントキャリブレーション機能】を搭載。安定した高精度実装を実現。



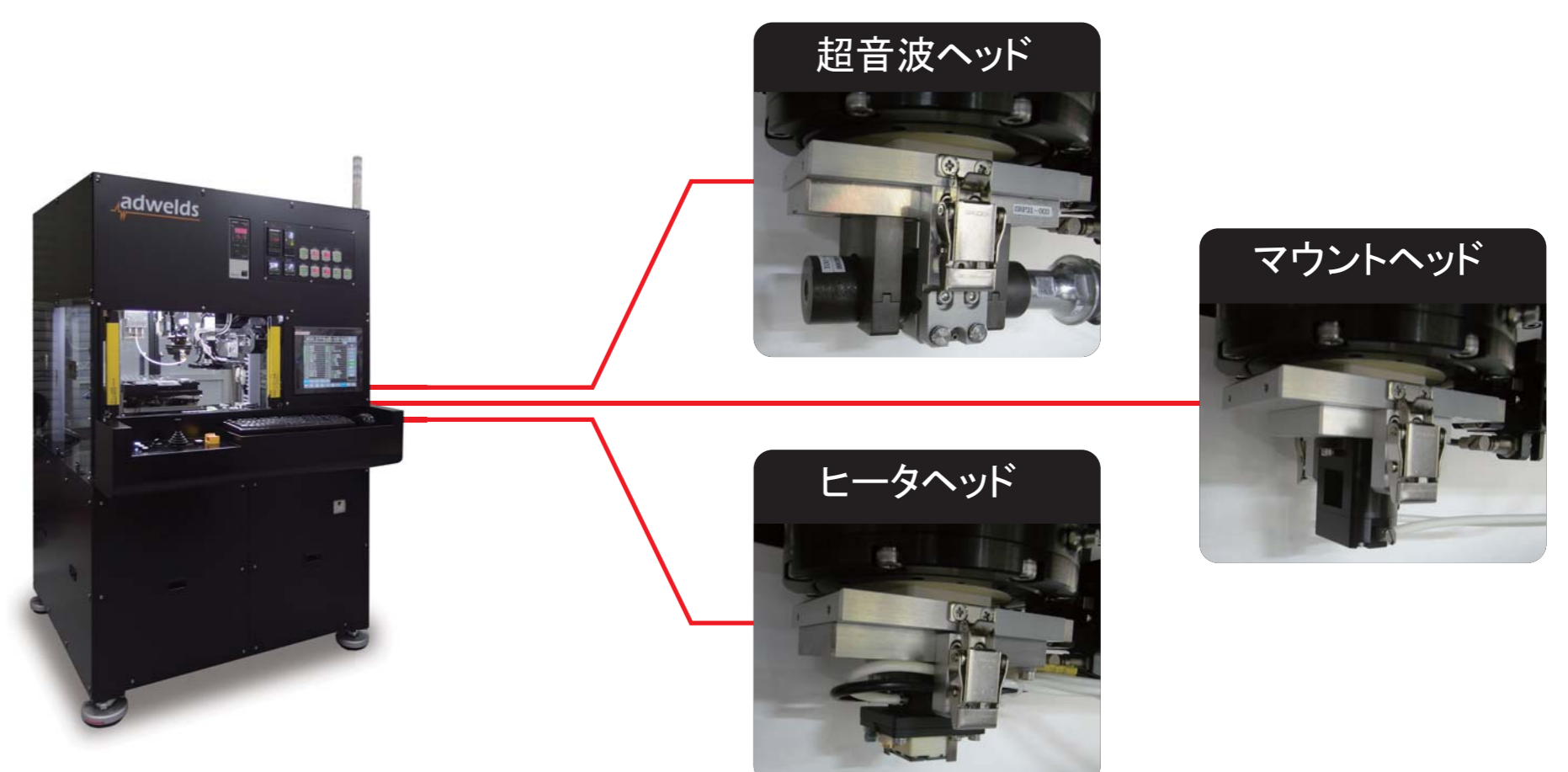
高機能位置荷重制御

低摺動加圧機構による広いダイナミックレンジを実現。接合時の変形に高い追従性を持ち、接合進展と共に荷重を上げるリニア加圧により接合性が向上。



ヘッド交換で各種プロセスに対応

接合プロセスに合わせて、容易にヘッド交換が可能。御要望にマッチする各種ヘッドをラインナップ。



株式会社アドウェルズ
福岡 本社
東京営業所
名古屋テクニカルセンター

<http://www.adwelds.com> Mail info@adwelds.com
〒811-1201 福岡県那珂川市片縄 8 丁目 140 番地
〒140-0004 東京都品川区南品川 5 丁目 10 番 45 号
〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂 4 丁目 206 番地
なごやサイエンスパーク 先端技術連携リサーチセンター内

TEL 092-555-6000
TEL 03-6433-9920